

Investor Relations 2017

Your Most Trustworthy



유의사항 Disclaimer

본 자료는 한국채택국제회계기준 연결실적에 대한 경영실적 및 재무성과를 바탕으로 작성되었습니다.

또한 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있으며, 이러한 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 불확실성으로 인하여, 실제 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

- 국내외 국가정책변경에 따른 세율 변동 (FTA, 관세, 법인세 등)
- 환율 및 이자 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향
- 주요 매출시장의 환경의 예상치 못한 급격한 변화
- 회사내의 전략적인 의사결정

이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과는 중대한 차이가 있을 수 있습니다.

Table of Contents

I. Company Overview

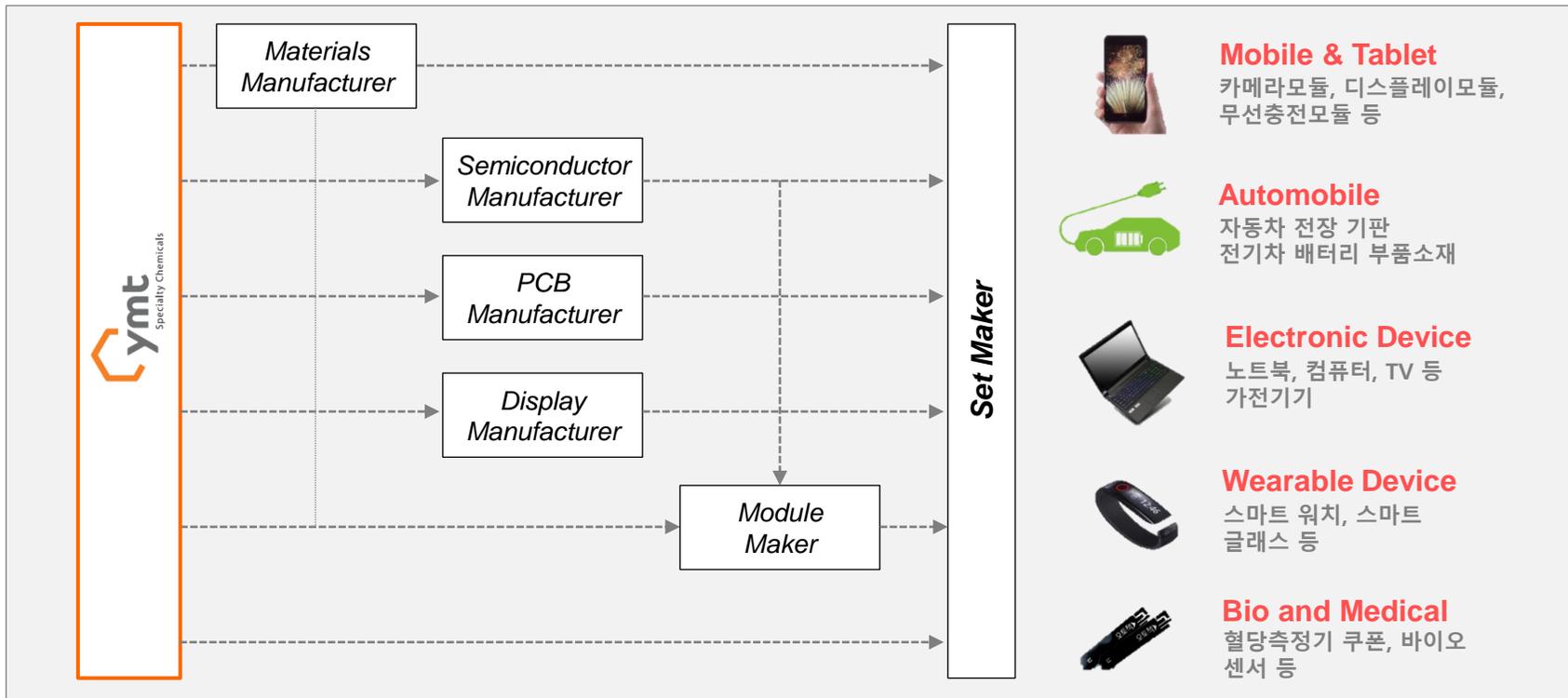
II. Market & Business

III. Investment Highlight

IV. Appendix

와이엠티는 전자소재 산업에서 반드시 필요한 **화학소재를 개발 / 제조하는 회사**로써, 모바일 뿐만 아니라 전기자동차, 웨어러블 디바이스, 바이오 센서 등에서도 그 가치를 인정받고 있습니다.

- ✓ 주요 표면처리 분야 : 무전해금도금 프로세스 [Soft ENIG / ENIG / ENEPIG], 무전해 화학동, 프로세스 케미컬
- ✓ 주요 고객사 : ZDT [Foxconn], 삼성전기, Unimicron, 심텍, BH Flex, 영풍전자, 인터플렉스 등



회사 개요
Company Overview

Customer List

Set
Maker



Semi-
conductor
Maker



PCB
Maker



Display
업체



YMT Co.,Ltd.

- 회사명 • 와이엠티(주)
- 설립일 • 1999. 02. 11
- 대표자 • 전성욱 (표면처리 기술사)
- 종업원 • 본사 129명 (한국 : 119명 / 대만 10명)
- 소재지 • 인천광역시 남동구 남동동로 153번길 30
- 자본금 • 1,142 백만원
- 주요제품 • PCB 화학소재
• 전자소재 분야
- 주요시장 • 모바일용 기판 및 모듈
• 무선충전기용 모듈
• Auto mobile 용 전장 부품
• 바이오 센서 등

YMT 본사 사업장 소개



제1공장

인천시 남동구 남동동로 153번길 30
면적 : 2527m²(지상4층 및 지하1층)
설비 : 탱크29기 및 연구소 설비
주요사항 : 기업부설연구소



제2공장

인천시 남동구 청능대로 337
면적 : 3026m²(지상3층/부속건물2동)
설비 : 탱크 47기 및 연구소 설비
주요사항 : 기업부설연구소,
위험물제조소 및 창고

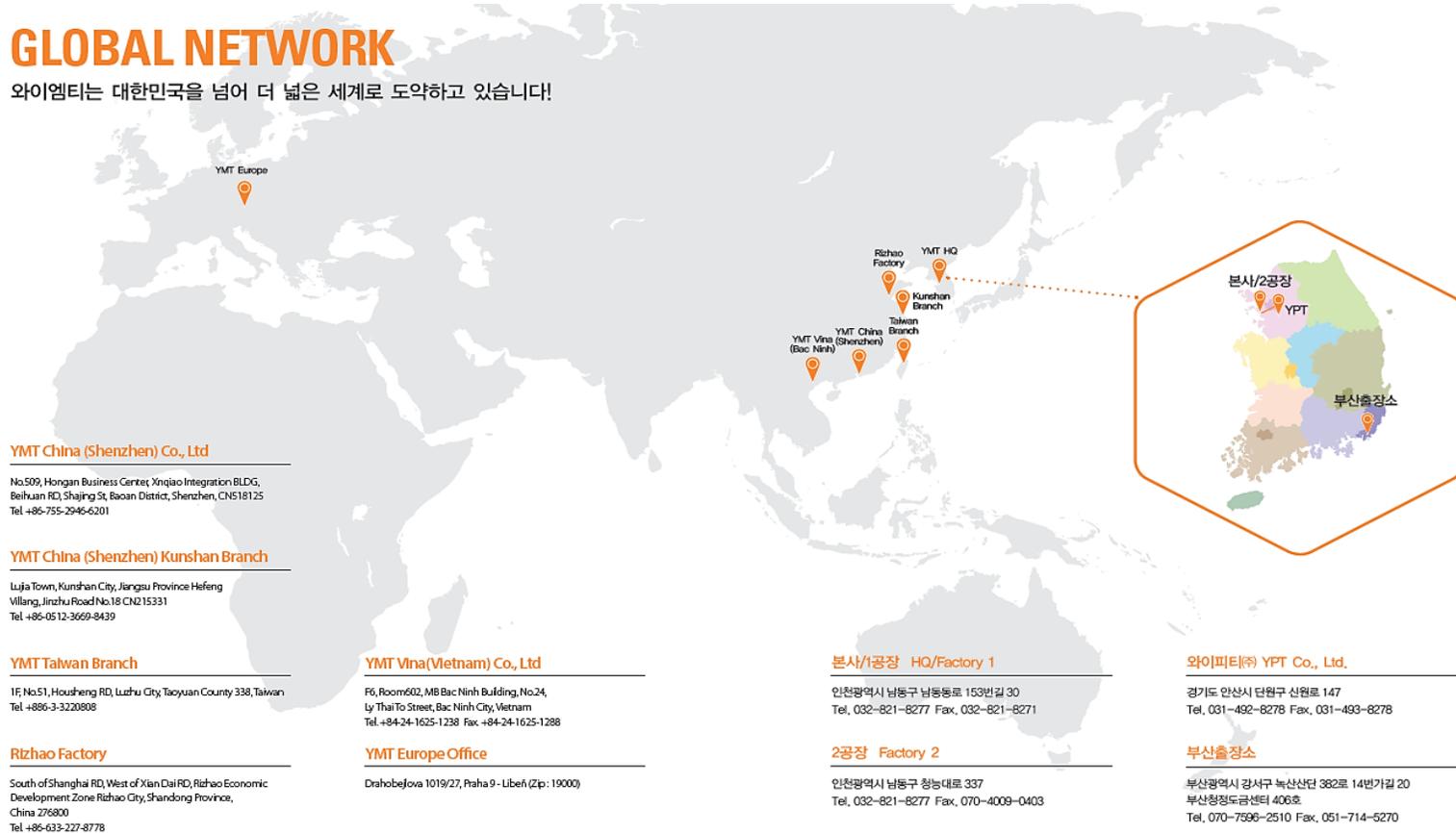


YMT Co.,Ltd Taiwan Branch

1F, No.51, Housheng RD, Luzhu
City, Taoyuan County 338, Taiwan
상주종업원 : 10명

GLOBAL NETWORK

와이엠티는 대한민국을 넘어 더 넓은 세계로 도약하고 있습니다



YMT China (Shenzhen) Co., Ltd

No.509, Hongan Business Centre, Xinqiao Integration BLDG,
BeiHuan RD, Shajing St, Baoan District, Shenzhen, CN518125
Tel. +86-755-2946-6201

YMT China (Shenzhen) Kunshan Branch

Lujia Town, Kunshan City, Jiangsu Province Hefeng
Village, Jinzhu Road No.18 CN215331
Tel. +86-0512-3669-8439

YMT Taiwan Branch

1F, No.51, Housheng RD, Luzhu City, Taoyuan County 338, Taiwan
Tel. +886-3-3220808

Rizhao Factory

South of Shanghai RD, West of Xian Dai RD, Rizhao Economic
Development Zone Rizhao City, Shandong Province,
China 276800
Tel. +86-633-227-8778

YMT Vina(Vietnam) Co., Ltd

F6, Room602, MB Bac Ninh Building, No.24,
Ly Thai To Street, Bac Ninh City, Vietnam
Tel. +84-24-1625-1238 Fax. +84-24-1625-1288

YMT Europe Office

Drahobejova 1019/27, Praha 9 - Libeň (Zip: 19000)

본사/1공장 HQ/Factory 1

인천광역시 남동구 남동동로 153번길 30
Tel. 032-821-8277 Fax. 032-821-8271

2공장 Factory 2

인천광역시 남동구 청능대로 337
Tel. 032-821-8277 Fax. 070-4009-0403

와이피티(주) YPT Co., Ltd.

경기도 안산시 단원구 신원로 147
Tel. 031-492-8278 Fax. 031-493-8278

부산출장소

부산광역시 강서구 녹산산단 382로 14번가길 20
부산청정도금센터 406호
Tel. 070-7596-2510 Fax. 051-714-5270

매출액 (단위: 억 원)

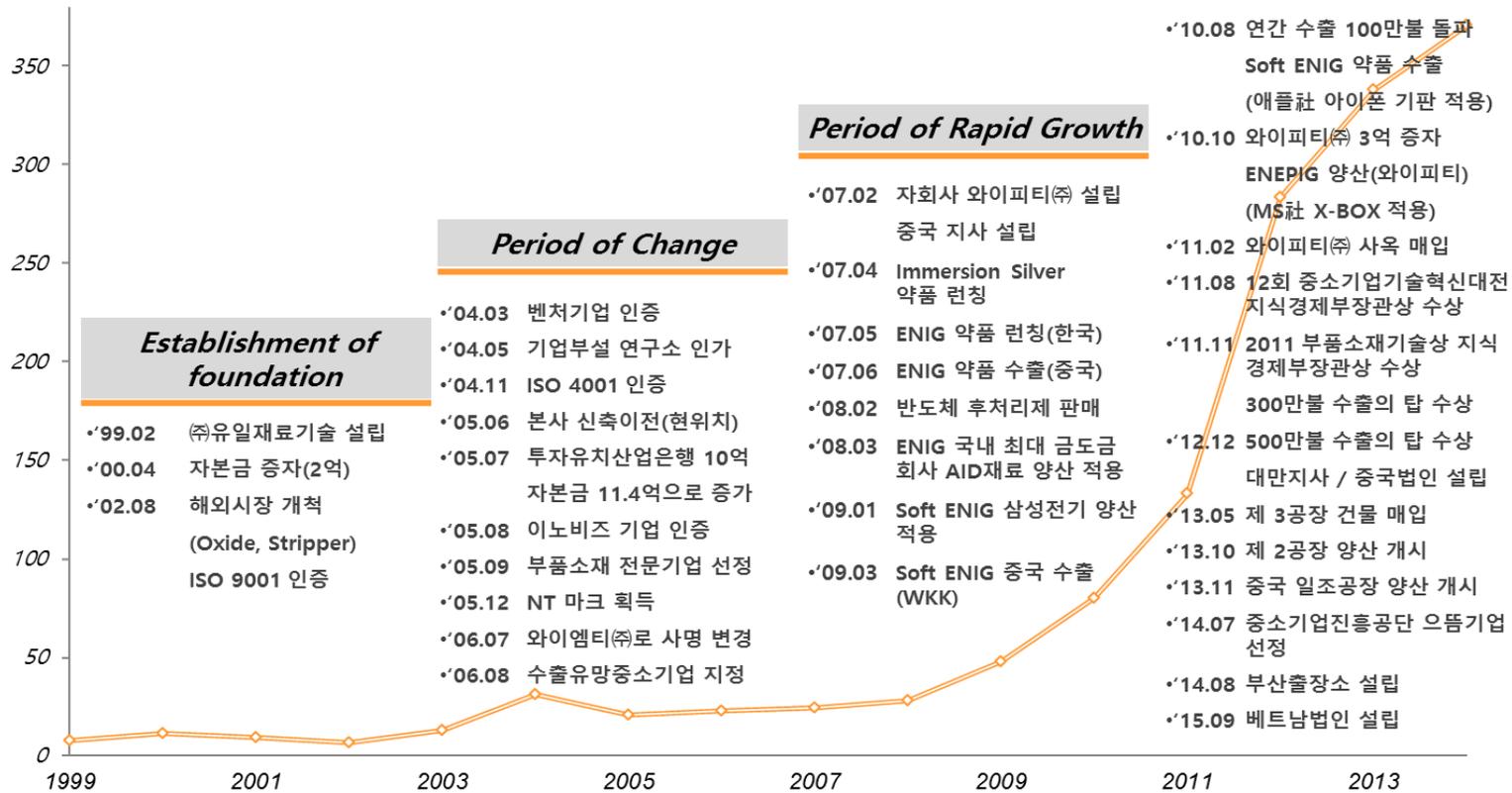


Table of Contents

I. Company Overview

II. Products Portfolio

III. Investment Highlight

IV. Appendix

Total Solution for Customer

와이엠티는 공정의 첫 단계인 세정,박리제 부터 최종 표면처리까지의 모든 화학소재 기술을 보유하고 있습니다.이에 저희는 고객사 설비 특성에 맞는 Total chemical solution을 제공하고 있습니다.



Finish Plating chemical

Soft ENIG Process

- ✓ CF 300 Series
- ✓ MIKO Series

ENIG Process

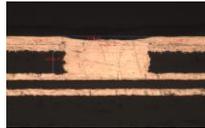
- ✓ PEN 855 Series

ENEPIG Process

- ✓ ELP Series
- ✓ IR Gold Series

TIN Plating process

- ✓ Bright and Matte finish
- ✓ Immersion tin process



Copper plating chemical

Electroless Copper plating

- ✓ Desmear Process
- ✓ HVF Series

Electronic Copper plating

- ✓ BJ series
- ✓ HBJ Series(Half-fill)
- ✓ VFBJ Series(Via-fill)



Process Chemical

DES Chemical

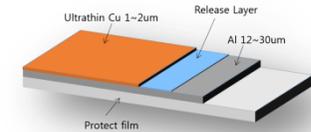
- ✓ DR Series
- ✓ SE Series
- ✓ SAC Series

Cleaner

- ✓ FXC Series
- ✓ TDF / MDF Series

Others

- ✓ Gold Recover
- ✓ Foamkiller Series
- ✓ CAROAT



Electronic Materials

Ultra Thin Copper Foil

- ✓ EMI Shield
- ✓ FCCL

Roll to Roll

- ✓ RTR 동도금 외주

Finish Plating

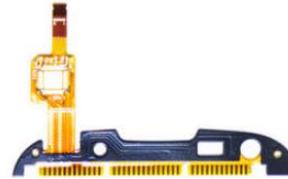
최종 표면처리 화학소재

구리 산화 방지 및 **기판 & 반도체의 표면을 보호**하기 위한 최종 표면처리 프로세스로 당사의 금도금 프로세스 소재 중 Soft ENIG Process는 **세계 최고수준의 기술력과 글로벌 M/S 1위**를 점유



금도금 프로세스 처리 후 기판

Soft ENIG Process



- ✓ FPCB 전용 금도금 프로세스
- ✓ 글로벌 M/S 및 기술력 1위
- ✓ 초 미세회로 구현 가능
- ✓ 우수한 내 절곡성으로 Nickel Crack 문제 해소
- ✓ 삼성전자, 애플 제품 탑재

ENEPIG Process



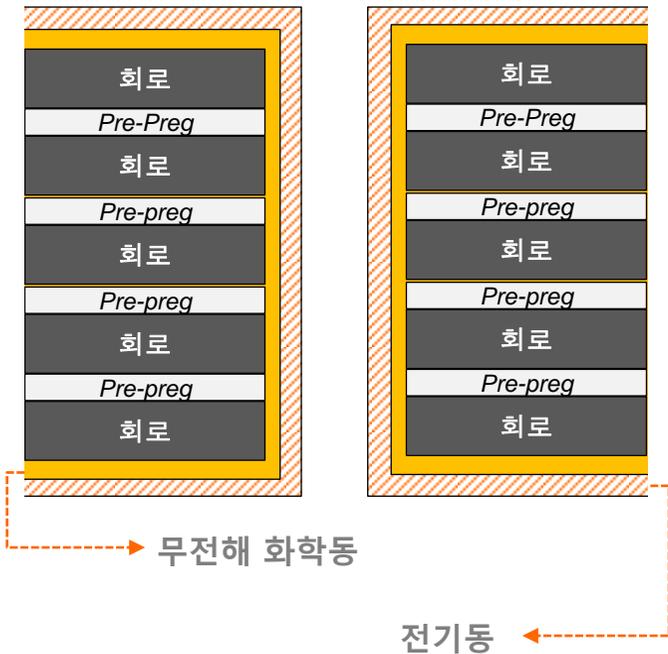
- ✓ 카메라 모듈등에 적합한 미세회로 최종 표면처리
- ✓ 글로벌 Top tier 점유율 확보
- ✓ 원가경쟁력 및 기술경쟁력 확보

Copper Plating

동도금 화학소재

드릴을 통해 가공된 홀을 구리 도금을 통해 층간 전기적 연결을 얻어내는 공정용 화학소재로 Multi Layer(다층기판)의 수요증가, RF PCB의 적층수 향상, 회로의 미세화로 하이엔드 동도금 화학소재 성장이 전망됨

PCB Hole 구조



Electroless copper plating

[무전해화학동]



- ✓ 세계 최고수준의 기술력 보유
- ✓ 부도체 물질에 화학적 전도성을 부여하는 공정
- ✓ 17년부터 본격적 매출 확대 전망

Electronic copper plating

[전기동]



- ✓ 동의 석출로 원하는 동 두께를 도금 하는 공정
- ✓ 원하는 위치와 두께를 형성하기에 적합
- ✓ 타사대비 도금두께 균일성 유지력 뛰어남
- ✓ 높은 수율로 가격 경쟁력 유리

Process Chemical

공정용 화학소재

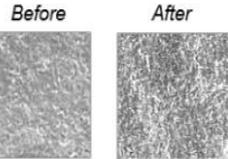
PCB 생산공정 및 전자부품소재 공정에 사용되는 화학소재로
DRY FILM에 사용되는 박리제부터 플렉스 세정제에 이르는 다양한 화학소재 제품 보유

DR Series (박리)



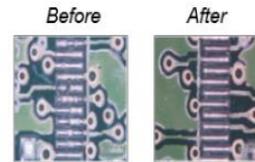
- ✓ 고객사별 제품 특성에 맞는 박리제 보유
- ✓ 빠른 박리효과 및 높은 수율

SE Series (소프트 에칭)



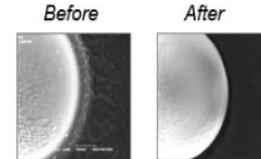
- ✓ 균일한 Copper 조도 형성 가능
- ✓ D/F 및 PSR 밀착력 상승을 통한 높은 수율 확보

Gold Recover



- ✓ 표면처리 후 금 표면의 오염물질 제거
- ✓ 타사 대비 오염물질 세정능력 매우 우수

Cleaner



- ✓ 디플렉스 세정액으로 수계, 유기계 2가지 Type
- ✓ 장비 내의 먼지를 제거 시켜 불량률 감소
- ✓ 메탄올 등 유해물질 없이 친환경 제품으로 공급

Table of Contents

I. Company Overview

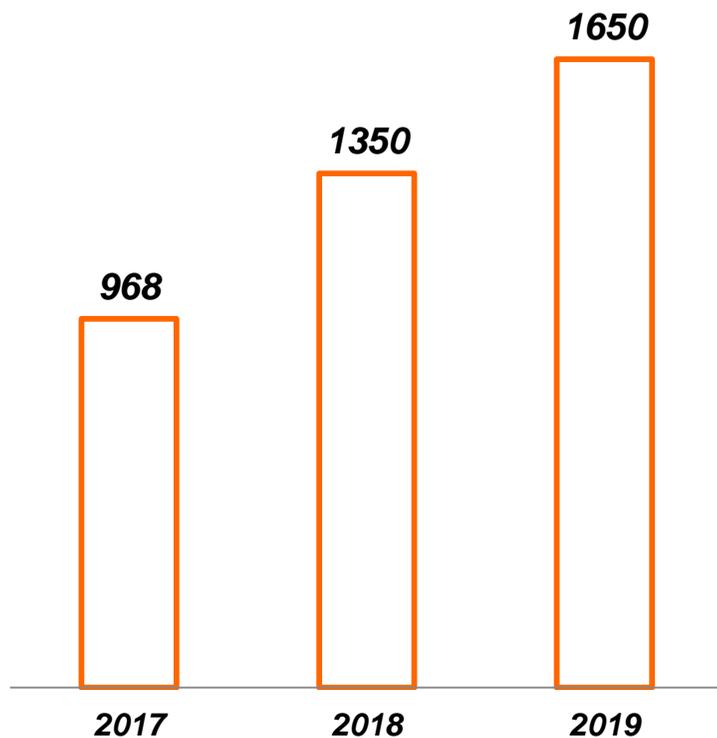
II. Products Portfolio

III. Investment Highlight

IV. Appendix

I Phone 向 RF PCB 시장 규모

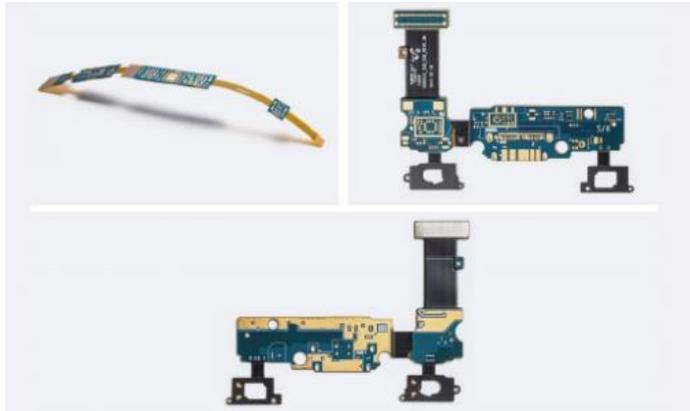
(단위 : 십억원)



애플 OLED 向 RF PCB 시장 물량 증대

- 삼성디스플레이의 애플向 OLED 수주
 - ✓ 향후 3년 삼성디스플레이에서 독점 공급 전망
 - ✓ 기존의 중국 / 한국 물량이 아닌 일본 물량의 이전으로 시장 물량은 순증
- SDC 벤더의 물량 및 매출 확대 전망
 - ✓ 16년 RF PCB 시장규모는 약 9,700억원으로 예상됨
 - ✓ 주요 수혜 벤더는 **인터플렉스, 삼성전기, 비에이치, 영풍전자**임
 - ✓ 상기 고객사는 **당사의 Major 고객사로 당사 또한 17년 및 향후 한국시장에서의 물량 및 매출 확대가 전망됨**
- 소형 OLED의 시장 점유 확대 예상에 따른 폭발적인 물량 증가 전망
 - ✓ 갤럭시 S8과 아이폰8을 필두로 중국 Local 브랜드 하이엔드 스마트폰 뿐만 아니라 중저가 폰에도 OLED 적용 전망

What is RF PCB?



- ✓ 디바이스의 고기능화 및 다기능화로 신호 전달의 역할을 하는 PCB 또한 고밀도화, 즉 "**경박단소화**"
- ✓ RF PCB는 Rigid PCB와 Flexible PCB의 하이브리드 형태로, FPCB의 굴곡으로 인한 회로 연결이 가능
→ **다량의 데이터 전송 및 소형화에 매우 유리**
- ✓ PCB 사이즈의 감소효과로 초고사양 스마트폰, 반도체, 배터리 및 웨어러블 등의 디바이스에 적용

초 고사양 RF PCB 로 인한 기술 패러다임 전환

- 아이폰 8용 OLED 기판은 R/F 5층 기판
 - ✓ 갤럭시 S8은 R/F 4층 전망
- 40 x 40 억대 아이폰 회로종 가장 세밀화
 - ✓ 당사의 최종표면처리 프로세스 중 **무전해금도금 프로세스인 CF 300 series로 최종 표면처리**
- 특수 소재로 인한 당사의 하이엔드 화학동 니즈 증가
 - ✓ 애플의 신소재 적용으로 기존 사용하던 공정 대비 까다로운 화학소재 필요
 - ✓ 당사의 **하이엔드 무전해화학동 소재가 경쟁사 대비 매우 우수한 품질로 아이폰 向 OLED 기판에 적용**
- 기존 외산이 점유하고 있던 시장에서 당사의 기술적 우위로 M/S 증가 예상

기존 스마트폰에 국한되어 있던 하이엔드 디바이스의 다변화

전기자동차 & 자율주행자동차 시대의 개막



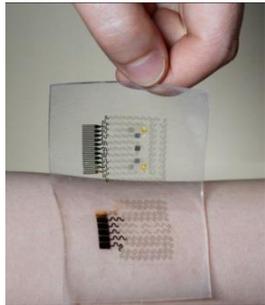
- 전기자동차 = 커다란 스마트폰 → 곧 하이엔드 전자 부품의 수요를 증대
- ✓ 현재 당사의 제품이 Foxconn을 통하여 중국 최대 전기자동차 업체인 BYD의 전장에 탑재

- 자율주행자동차 : 자율 주행을 위한 카메라모듈, 센서 등 높은 신뢰성을 요구하는 **하이엔드 부품소재에 대한 니즈 증가**

Foldable Display의 등장



- Foldable Display로 인한 "굴곡성", "내절곡성"을 요구하는 하이엔드 소재의 등장 → **새로운 FPCB, RF-PCB 사양 요구**
- 새로운 소재와 기판에 대한 하이엔드 화학소재 니즈 증가



- 현재 스마트 워치 정도의 1세대 웨어러블 디바이스에서 향후 섬유와의 결합, Patchable 등으로 확대될 전망
- 높은 신뢰성과 친환경, 현재보다 더욱 얇은 디바이스를 위해 **경박단소화된 기판과 모듈에 대한 수요 증가**

Wearable Device의 성장

- 심박센서, 온도계, 혈당 측정기 등 헬스케어 분야의 디지털화가 빠르게 진행중
- 당사는 현재 대만의 의료회사와 당사의 화학소재로 처리한 혈당측정기 쿠폰에 대해서 신뢰성 테스트 중



Health Care분야의 성장

Global 기술 강소 기업

중국법인 [심천, 쿤산]

- 중국 내 Top tier PCB 회사 거래
 - ✓ 주요 고객사 : ZDT (Foxconn), Unimicron, Nanya PCB 등)
- 시장 내 고품질 고가격 Top Brand로 포지셔닝
- 현지 인력으로 100% 운영되고 있으며 중국 현지 최고수준의 엔지니어 보유
- 17년 중국이 듀얼카메라 모듈 성장으로 당사의 ENEPIG 프로세스의 매출 확대 예상

베트남 법인[박닌]

- 베트남 시장의 성장
 - ✓ BH Flex의 애플 OLED 向 기판 양산
 - ✓ 삼성전기의 OLED 기판 설비 투자
 - ✓ 또한 일본을 비롯한 대만, 중국의 PCB 제조사들이 베트남 시장에 투자
- 시장 물량 증가에 따른 17년 흑자전환 전망
- 현지 Engineer 확보로 현지 직원에 의한 고객사 대응
- 현재 17년 4분기 양산을 목표로 현지공장 Set-up중

대만지사 및 중국 OEM 공장

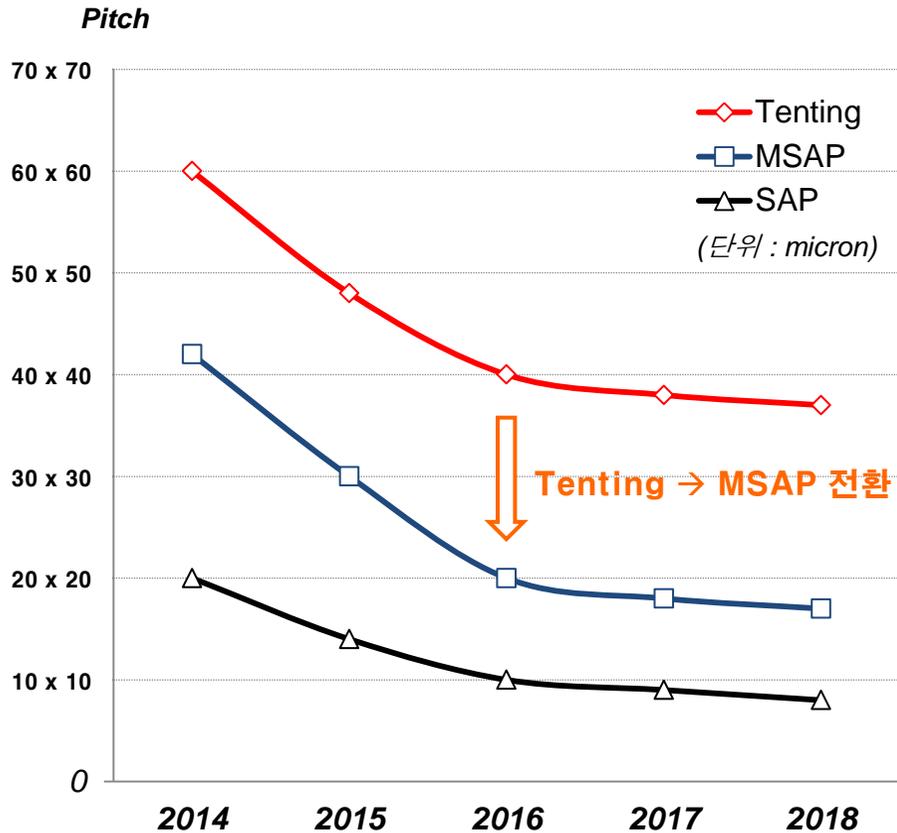
대만지사[YMT HQ]

- ZDT를 비롯한 중국 PCB 회사의 본사는 대만에 위치
- 대만 본사를 대상으로 한 기술 영업 및 현지 고객사 판매중

일조 OEM 공장

- 중국 Rizhao 지역에 당사의 OEM 생산공장 위치
- 중국에서 외국기업은 보유하기 힘든 화학약품제조업 허가 보유

공법에 따른 회로폭 & Pitch 트렌드



Fine-pitch에 대한 중요도 증가

- ✓ 기기의 슬림화 트렌드와 반대로 홍채인식, 지문인식, 심박센서 등 탑재되는 모듈은 증가하는 추세 → 회로 세밀화, 소재 변환

MSAP 공법으로의 전환 전망

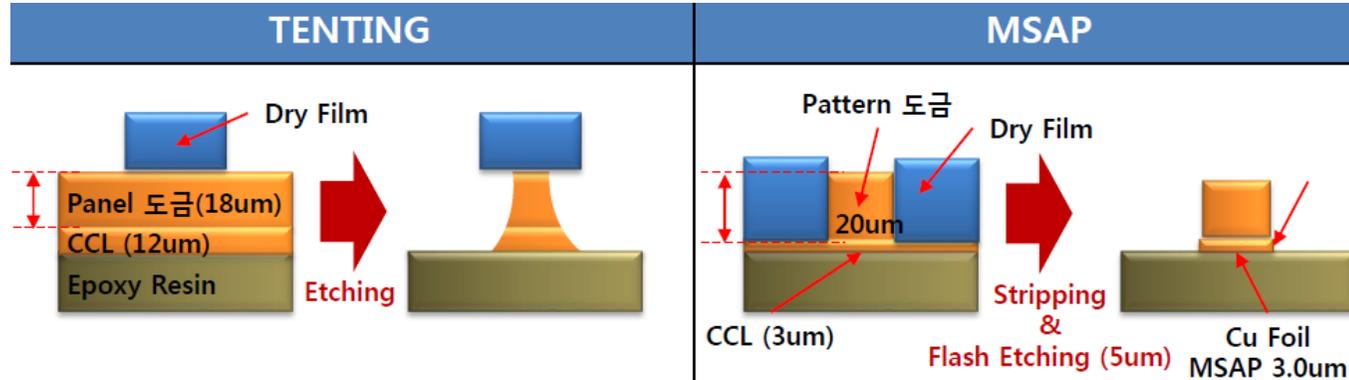
- ✓ 텐팅공법의 한계로, HDI 기판이 MSAP 으로 전환 전망
- ✓ 텐팅공법 : 회로 주위를 에칭하여 회로를 구현
- ✓ MSAP : PKG 공법으로 회로를 도금으로 쌓아올려 구현



고객사 화학소재 Supply Chain의 변화로 인한 수혜

- ✓ 최종표면처리 : 당사의 금도금 프로세스는 세계 최고의 기술수준으로 MSAP 공법에서 요구하는 사양을 충족
- ✓ 동도금소재 : 더욱 다양한 부품실장을 위한 다층기판의 하이엔드 화학동 소재의 매출 증가 예상(Via fill 등)
- ✓ Process Chemical : MSAP 전용 박리제 등
- ✓ 동박 : 기기 세밀화에 따른 Thin Copper 니즈 증대

SLP(MSAP) 공법이란?



아이폰 8 SLP HDI 기판 적용

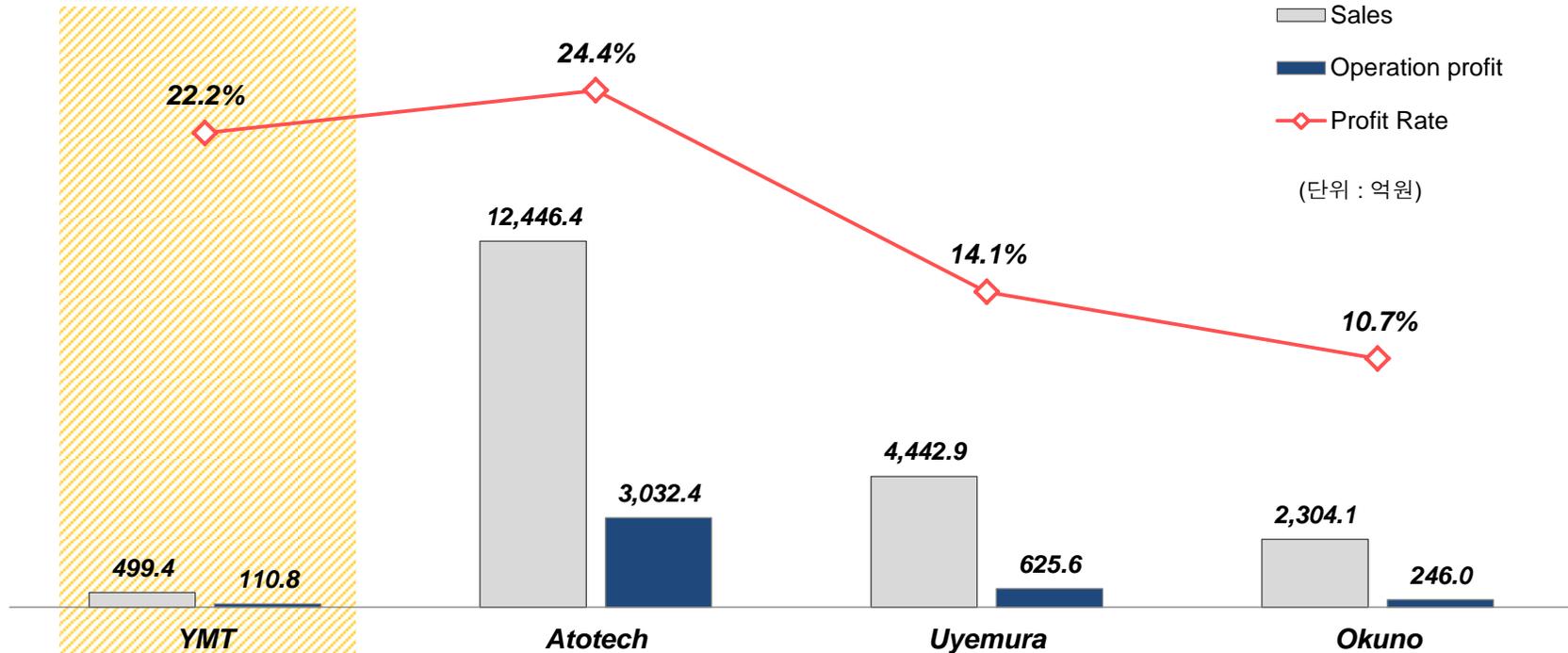
- ✓ 아이폰 8에는 최초로 SLP(MSAP)공법으로 제작된 HDI 탑재 예정
- ✓ AT&S / TTM / COMPEQ / IBIDEN / ZHEN DING / KINSUS / UNIMICRON

국내 HDI 제조사들의 SLP 설비 투자

- ✓ 차기 삼성전자의 프리미엄 휴대폰의 메인 기판이 SLP 공법으로 제작될 예정
- ✓ 이에 따라 국내의 삼성전기, 코리아써키트, 대덕전자, 이노텍, 이수페타시스 등 기판 업체의 설비 투자 진행중

향후 MSAP 공법은 FPCB / RFPCB 향으로 공법이 적용될 예정

최고의 기술력으로 글로벌 화학 대기업들과 시장 경쟁



당사의 경쟁사는 회사는 일본과 독일회사들로 최소 2,300억 ~ 1조 2천억의 종건 , 대기업이나 당사의 주요제품은 상기 회사들을 따돌리고 애플과 삼성전자 하이엔드 스마트폰에 탑재되고 있음

반도체 화학소재 시장 진출

반도체 Wet Chemical 시장 진출

- ✓ 16년 4분기 개발 및 영업 인력 Set-up 완료
- ✓ UBM 에천트, Cu 에천트 등 반도체 후공정 화학소재를 독자 기술로 개발 완료
- ✓ 17년 2분기 부터 양산 예정
- ✓ PCB 대비 고부가가치 시장으로 17년 추가 투자를 통해 매출이 확대될 전망

일본 S社 PSR 에칭 화학소재

- ✓ Substrate의 경박단소화에 따라 새로운 소재의 니즈 증가
- ✓ 얇지만 휘어지지 않는 S사의 L소재에 대한 PKG 고객사의 니즈가 증가
- ✓ L소재는 기존의 화학소재가 아닌 현재 당사가 개발한 화학소재로만 에칭이 되고 있음

→ 현재 한국 및 일본 Package 업체와 NDA 및 17년 3분기 양산 전망

기술 시너지를 이용한 화학소재 진출

원천기술 보유로 시장성이 있는 타분야 진출

인테나
화학동

- ✓ 당사의 무전해화학동 기술을 이용한 플라스틱 상에 동 회로 구현 성공
- ✓ 인테나 모듈 수신을 위한 스마트폰 내부 플라스틱 파트 위 회로구현
- ✓ 갤럭시 S8 탑재 예정

Flux
세정제

- ✓ 카메라 모듈등의 남아있는 이물제거제
- ✓ 특수 물질에 대한 세정력이 확보되어야 하는 고부가가치 세정제로 국내 대기업 및 외산 기업이 경쟁중
- ✓ 17년 2분기부터 매출 확대 예상

자동차
열선
흑화처리

- ✓ 기존 자동차 앞유리를 공조기로 습기를 제거하는 방식이 아닌, 자동차 앞유리에 얇은 구리선을 내장하여 습기를 제거하는 방식
- ✓ 얇은 구리선이 빛에 반사되지 않기 위하여 흑화처리 하는 화학소재를 현재 대기업에 공급중

Growth Engine#2 : 동박[Ultra thin copper foil]

세계 최초로 무전해화학동 공법을 이용하여 생산된 당사의 극동박은 EMI 차폐, FCCL, 방열 필름등으로 다양하게 활용이 가능하며, 외산이 점유하고 있는 시장에서 높은 매출성장이 기대되고 있음

RTR 생산 설비



- ✓ 모재를 회전롤에 감으면서 약품을 도포하여 동박을 생산 하는 설비
- ✓ 현재 월 15,000m² Capa.

극박형 동박



- ✓ EMI 차폐와 FCCL의 원소재가 되는 동박으로 2um~6um 정도의 매우 얇은 극박
- ✓ 세계최초 무전해화학동 기법으로 생산된 동박

EMI 차폐 Sheet



- ✓ 알루미늄 캐리어와 동으로 구성된 동박 형태
- ✓ 전자파 차단과 방열 소재로 향후 성장이 매우 기대되는 전자소재

PET CCL



- ✓ 당사의 동박을 이용하여 제작된 FCCL
- ✓ 향후 기판의 경박단소화가 트렌드로 대두되어, 성장이 예상됨

현재 전세계적 동박 Shortage 현상과 더불어 당사는 향후 당사의 가장 큰 성장동력으로 확신하고 있으며, 17년 3분기 소재 대기업과의 사업제휴를 통한 EMI 차폐 동박이 양산 예정되어 있음

Table of Contents

I. Company Overview

II. Products Portfolio

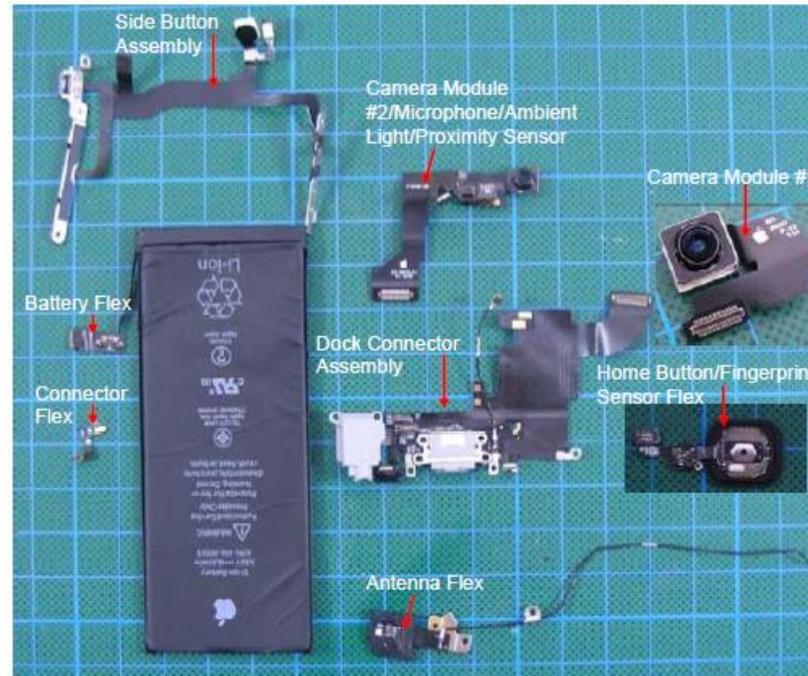
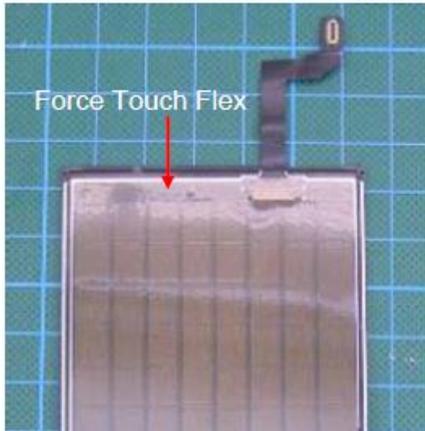
III. Investment Highlight

IV. Appendix

I-Phone 6S Utilization of FPCB

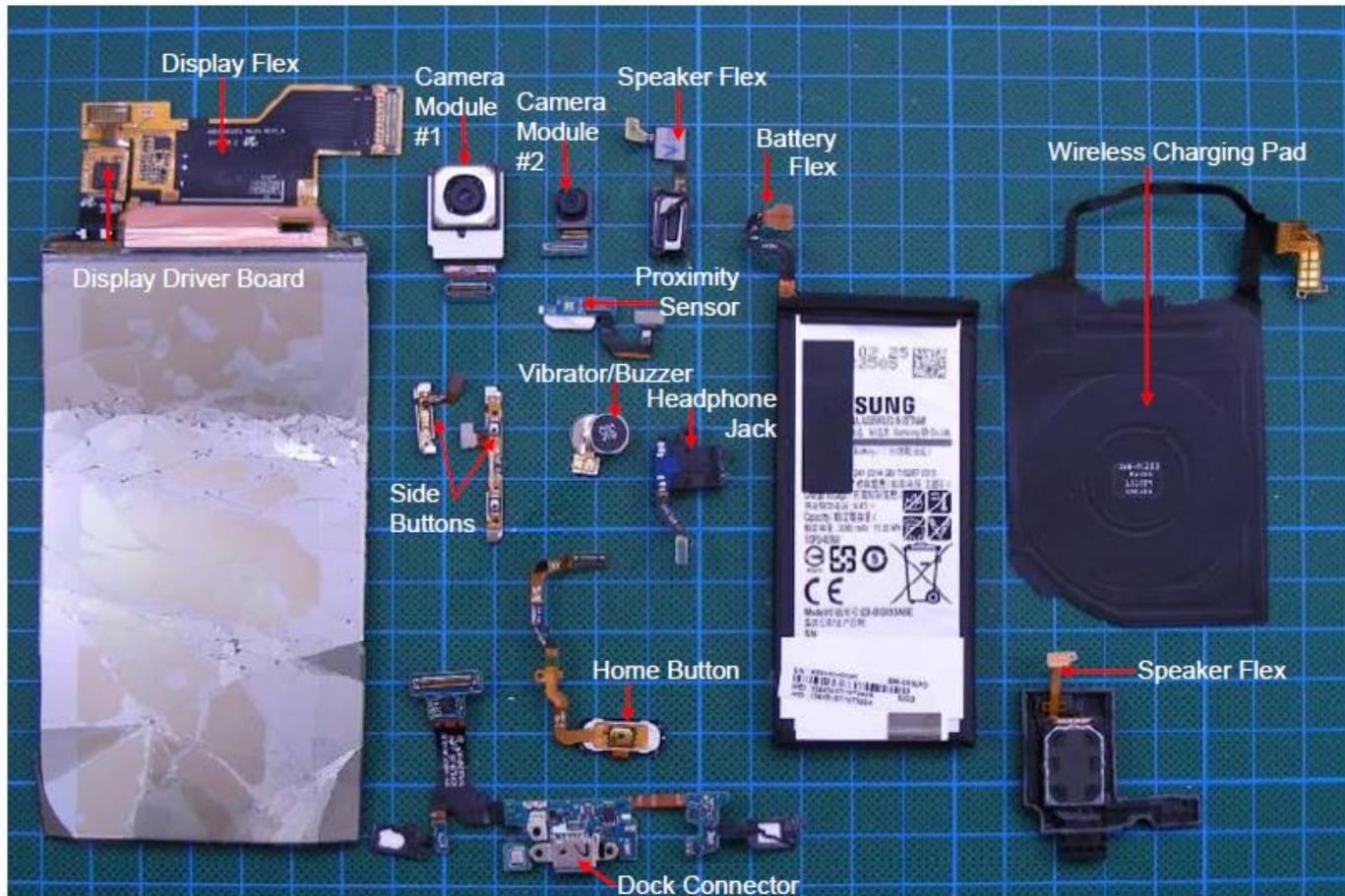
주요 FPCB 부품

- ✓ Camera Module#1
- ✓ Camera Module#2
- ✓ Speaker Flex
- ✓ Vibration / Buzzer
- ✓ Flex for home Button
- ✓ Contact Flex to Main PCB
- ✓ Side Button
- ✓ Dock Connector
- ✓ Headphone Jack
- ✓ Display Flex
- ✓ Display Driver Board
- ✓ Battery Flex



Galaxy S7 Utilization of FPCB

주요 FPCB 부품



- ✓ Camera Module#1
- ✓ Camera Module#2
- ✓ Speaker Flex
- ✓ Proximity Sensor
- ✓ Vibration / Buzzer
- ✓ Flex for home Button
- ✓ Wireless Charging Pad
- ✓ Side Button
- ✓ Dock Connector
- ✓ Headphone Jack
- ✓ Display Flex
- ✓ Display Driver Board
- ✓ Battery Flex

Appendix

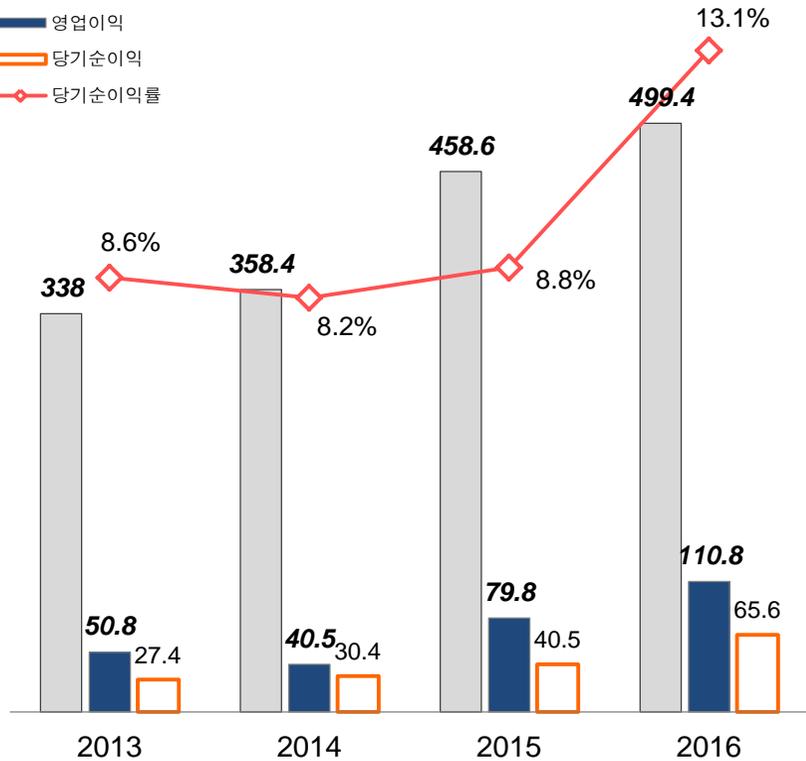
Income statement

YMT Group Sales & profit

(단위 : 억원)

(연결기준)

- 매출액
- 영업이익
- 당기순이익
- ◇ 당기순이익률

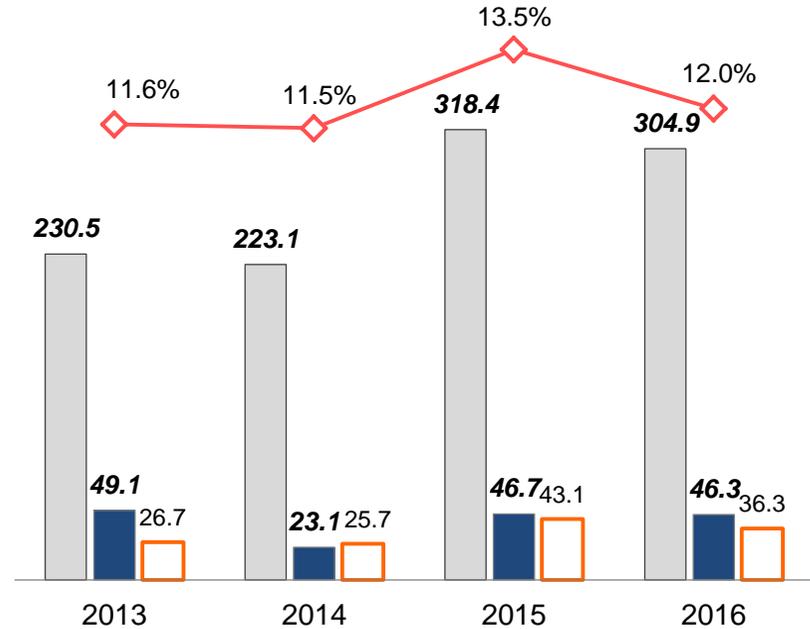


YMT HQ Sales & Profit

(단위 : 억원)

(개별기준)

- 매출액
- 영업이익
- 당기순이익
- ◇ 당기순이익률



* YMT HQ 지배기준 당기순이익

Appendix

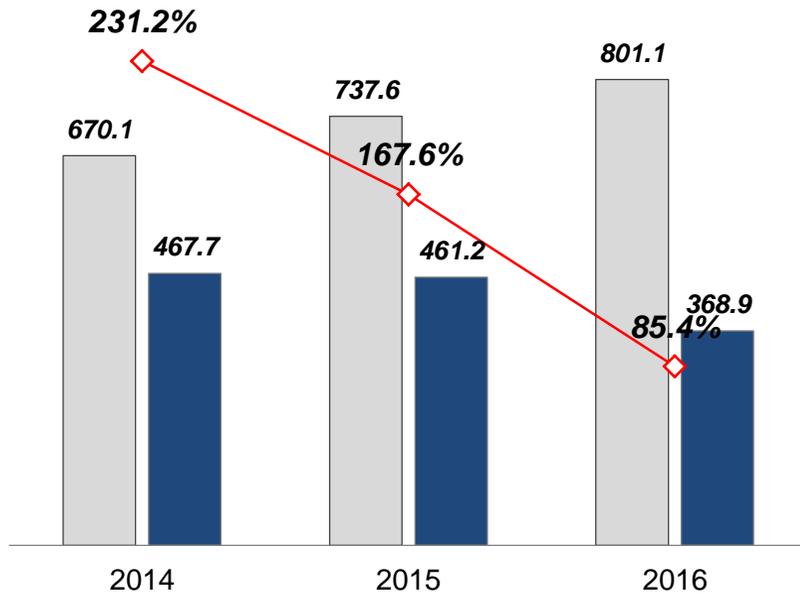
Income statement

(단위: 백만원)

| | 2016 | | 2015 | | 2014 | | 2013 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 개별 | 연결 | 개별 | 연결 | 개별 | 연결 | 개별 | 연결 |
| 매출액 | 30,494 | 49,940 | 31,839 | 45,864 | 22,313 | 35,839 | 23,054 | 33,803 |
| 매출원가 | 19,685 | 29,284 | 19,075 | 26,869 | 14,598 | 23,781 | 13,860 | 23,333 |
| 매출총이익 | 10,808 | 20,656 | 12,764 | 18,995 | 7,715 | 12,058 | 9,194 | 10,470 |
| 판매비와관리비 | 6,174 | 9,576 | 8,094 | 11,016 | 5,409 | 8,013 | 4,289 | 5,388 |
| 영업이익 | 4,635 | 11,080 | 4,670 | 7,979 | 2,306 | 4,045 | 4,905 | 5,082 |
| 영업외수익 | 2,112 | 2,150 | 3,233 | 1,970 | 2,292 | 2,336 | 492 | 1,104 |
| 영업외비용 | 2,315 | 2,936 | 2,780 | 3,642 | 2,417 | 2,939 | 2,463 | 2,861 |
| 법인세차감전순이익 | 4,432 | 10,294 | 5,123 | 6,307 | 2,181 | 3,442 | 2,934 | 3,325 |
| 당기순이익 | 3,626 | 6,456 | 4,311 | 4,049 | 1,926 | 3,044 | 2,668 | 2,743 |
| EBITDA | 6,222 | 13,496 | 6,008 | 10,053 | 3,342 | 5,603 | 5,848 | 6,448 |

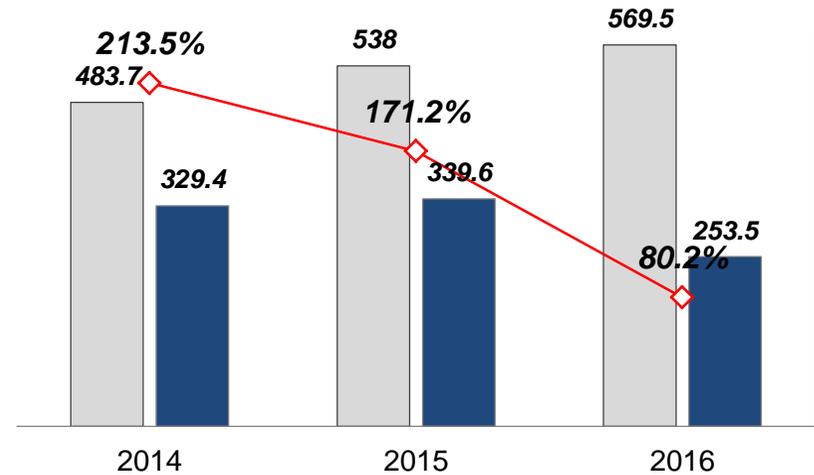
YMT Group Sales & profit

■ 자산 ■ 부채 ◇ 부채비율



YMT HQ Sales & Profit

■ 자산 ■ 부채 ◇ 부채비율



전환우선주의 보통주 전환 및 일부 대출금 상환을 통해 재무건전성 향상

Appendix

Balance Sheet

(단위: 백만원)

| | 2016 | | 2015 | | 2014 | | 2013 | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 개별 | 연결 | 개별 | 연결 | 개별 | 연결 | 개별 | 연결 |
| 유동자산 | 21,750 | 38,317 | 22,586 | 34,566 | 18,676 | 30,094 | 13,503 | 19,353 |
| 비유동자산 | 35,202 | 41,790 | 31,213 | 39,197 | 29,695 | 36,915 | 28,612 | 34,451 |
| 자산총계 | 56,952 | 80,107 | 53,799 | 73,763 | 48,371 | 67,009 | 42,115 | 53,804 |
| 유동부채 | 13,670 | 21,285 | 19,424 | 31,048 | 19,538 | 32,517 | 12,329 | 16,268 |
| 비유동부채 | 11,683 | 15,606 | 14,537 | 15,150 | 13,403 | 14,257 | 16,493 | 21,322 |
| 부채총계 | 25,353 | 36,891 | 33,961 | 46,198 | 32,941 | 46,774 | 28,822 | 37,590 |
| 자본금 | 1,543 | 1,543 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 기타자본 | 9,089 | 9,051 | 1,394 | 6,187 | 1,442 | 3,169 | 1,193 | 2,142 |
| 이익잉여금 | 20,967 | 32,622 | 17,301 | 20,235 | 12,845 | 15,923 | 10,957 | 12,929 |
| 자본총계 | 31,599 | 43,216 | 19,838 | 27,565 | 15,430 | 20,235 | 13,293 | 16,214 |
| 현금흐름 | 75 | 3,069 | 1,938 | -21 | 660 | 3,919 | -1,390 | -75 |
| 기말현금 | 4,461 | 10,848 | 4,386 | 7,778 | 2,448 | 7,799 | 1,788 | 3,880 |
| 순차입금 | 17,898 | 25,478 | 18,937 | 26,649 | 22,156 | 30,614 | 21,348 | 29,156 |
| Capex | 4,490 | 4,711 | 9,703 | 11,451 | 3,020 | 5,113 | 11,940 | 13,392 |